

原采购信息内容：

第三章 采购内容及要求

“3. 为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为 $\geq 320*240\text{mm}$ ”

“8. 产品采用高端芯片，支持芯片级低压供电，采用 IDES 智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能 70%以上”

“32. 为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为 $\geq 320*240\text{mm}$ ”

“37. 产品采用高端芯片，支持芯片级低压供电，采用 IDES 智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能 70%以上”

变更为：

第三章 采购内容及要求

“3. 模组尺寸：模组尺寸 $\geq 320*240\text{mm}$ ，若模组尺寸低于该标准，需提供保障平整度的可行性措施方案”

“8. 产品采用高端芯片，支持芯片级低压供电，采用 IDES 或其他智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），全套节能功能同步开启状态下，相比关闭全部节能功能的同工况，综合功耗降低 $\geq 70\%$ 。”

“32. 模组尺寸：模组尺寸 $\geq 320*240\text{mm}$ ，若模组尺寸低于该标准，需提供保障平整度的可行性措施方案”

“37. 产品采用高端芯片，支持芯片级低压供电，采用 IDES 或其他智慧节能技术，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），全套节能功能同步开启状态下，相比关闭全部节能功能的同工况，综合功耗降低 $\geq 70\%$ 。”

凡竞争性磋商文件中涉及到此内容的以变更后为准。其他内容不变，请各供应商以最新内容制作响应文件。